

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	(8)
รายการตาราง	(11)
รายการภาพประกอบ	(13)
สัญลักษณ์คำย่อและตัวย่อ	(18)
บทที่	
1. บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของหัวข้อวิจัย	1
1.2 ทฤษฎีและหลักการ	3
1.2.1 อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม (Aluminum and Aluminum Alloys)	3
1.2.2 การจำแนกประเภทของอะลูมิเนียมผสม	4
1.2.3 โลหะอะลูมิเนียมผสมสังกะสี (Al-Zn Alloys)	12
1.2.4 การเพิ่มความแข็งแรงโดยการเจาะจง (Aging or Precipitation Hardening)	
ของอะลูมิเนียมผสมกลุ่ม 7XXX	13
1.2.5 อะลูมิเนียมผสมเกรด 7075-T651	14
1.2.6 การคีป (Creep)	15
1.2.7 กลไกการคีป (Creep Mechanisms) ของโลหะบริสุทธิ์ และโลหะผสมชนิด M (Class M Alloy) และโลหะชนิดสารละลาย- ของแข็งชนิด A (Class A Alloy)	20
1.3 การตรวจสอบสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	24
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ	28
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	28
1.6 ขอบเขตของการวิจัย	28
1.7 สถานที่ทำการวิจัย	28
2. วิธีการวิจัย	29
2.1 วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย	29
2.2 ชิ้นทดสอบการคีป (Specimen for Creep Test)	29

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.3 อุปกรณ์จับยึดชิ้นทดสอบ (Specimen Holder)	30
2.4 เครื่องทดสอบและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล	31
2.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีของชิ้นตัวอย่าง	32
2.6 การทดสอบความแข็ง (Hardness Test)	32
2.7 การทดสอบแรงดึง (Tensile Test)	33
2.8 การทดสอบการคีบ (Creep Test)	33
2.9 การตรวจสร้างจุลภาคของโลหะผสมก่อนและหลังการทดสอบการคีบ	34
3. ผลและการอภิปรายผล	36
3.1 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีของตัวอย่างอะลูมิเนียมผสมเกรด 7075-T651	36
3.2 ผลการทดสอบความแข็ง	37
3.3 ผลการทดสอบแรงดึง	38
3.4 ผลการทดสอบการคีบ	41
3.4.1 เส้นโค้งการคีบ (Creep Curve)	41
3.4.2 ค่ายกกำลังของความเดิน (Stress Exponent, n)	45
3.4.3 พลังงานกระตุ้นสำหรับการคีบ (Activation Energy for Creep, Q_c)	51
3.5 โครงสร้างจุลภาค (Microstructures)	55
3.5.1 โครงสร้างจุลภาคของแผ่นโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด 7075-T651 ตามสภาพที่รับมา (As-Received Plate)	56
3.5.2 โครงสร้างจุลภาคของโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด 7075-T651 ที่ผ่านการให้ความร้อน (Pre-Heated) ก่อนการทดสอบการคีบ	57
3.5.3 โครงสร้างจุลภาคของโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด 7075-T651 ภายหลังการทดสอบการคีบที่อุณหภูมิ 150°C	58
3.5.4 โครงสร้างจุลภาคของแผ่นโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด 7075-T651 ภายหลังการทดสอบการคีบที่อุณหภูมิ 200°C	58
3.5.5 โครงสร้างจุลภาคของโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด 7075-T651 ภายหลังการทดสอบการคีบที่อุณหภูมิ 250°C	59

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.6 การอภิปรายผล	60
3.6.1 ค่าขากกำลังของความเด็น (Stress Exponent, n)	60
3.6.2 พลังงานกระตุ้นสำหรับการคีบ (Activation Energy for Creep, Q_c)	62
3.6.3 ตารางเปรียบเทียบค่า Q_c และค่า n	63
3.6.4 โครงสร้างจุลภาค (Microstructures)	64
4. บทสรุปและเสนอแนะ	65
4.1 สรุปผล	65
4.2 ข้อเสนอแนะ	66
บรรณานุกรม	68
ภาคผนวก	71
ก. แบบชิ้นทดสอบการคีบ	72
ข. แบบประกลบอุปกรณ์จับเข็มชิ้นทดสอบ	74
ก. ภาพถ่ายอุปกรณ์บันทึกข้อมูลทดสอบการคีบ	77
ง. ขั้นตอนการสอนเทียบหน้อแปลงไฟฟ้าแบบอนุพันธ์ที่ได้แบบเชิงเส้น (Linear Variable Differential Transformer)	85
จ. ขั้นตอนการกำหนดค่าโปรแกรมการดึงสำหรับทดสอบการคีบ(Creep Test) และขั้นตอนการกำหนดค่าโปรแกรมการบันทึกข้อมูลการคีบ	90
ประวัติผู้เขียน	104

รายการตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 กลุ่มของโลหะอะลูมิเนียมผสมที่ขึ้นรูป (Wrought Aluminum)	6
1.2 แสดงขั้นตอนของ Precipitation-Hardening	13
1.3 อุณหภูมิเกิดการคีบของโลหะบริสุทธิ์และโลหะผสมด้านทานอุณหภูมิสูง	16
3.1 องค์ประกอบเคมีของแผ่นโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด 7075-T651 ที่ใช้ในการวิจัยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานจาก ASM Handbook	36
3.1 (ต่อ) องค์ประกอบเคมีของแผ่นโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด 7075-T651 ที่ใช้ในการวิจัยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานจาก ASM Handbook	37
3.2 ผลการทดสอบความแข็งของแผ่นโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด 7075-T651	37
3.2 (ต่อ) ผลการทดสอบความแข็งของแผ่นโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด 7075-T651	38
3.3 สมบัติเชิงกลของโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด 7075-T651 จากการทดสอบแรงดึงที่ อัตราความเครียด (Strain Rate) คงที่ $1 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ และที่อุณหภูมิต่างๆ	38
3.4 สมบัติเชิงกลโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด 7075-T651 จากการทดสอบแรงดึงที่ อุณหภูมิ 150°C และ Strain Rate (hr^{-1}) ต่างๆ	41
3.5 ค่า Minimum Creep Rate (hr^{-1}) จากการทดสอบการคีบที่อุณหภูมิ 100°C ที่ระดับความเค้นการคีบระหว่าง 100-440 MPa	46
3.6 ค่า Minimum Creep Rate (hr^{-1}) จากการทดสอบการคีบที่อุณหภูมิ 150°C ที่ระดับความเค้นการคีบระหว่าง 80-380 MPa	47
3.7 ค่า Minimum Creep Rate (hr^{-1}) จากการทดสอบการคีบที่อุณหภูมิ 200°C ที่ระดับความเค้นการคีบระหว่าง 80-200 MPa	48
3.8 ค่า Minimum Creep Rate (hr^{-1}) จากการทดสอบการคีบที่อุณหภูมิ 250°C ที่ระดับความเค้นการคีบระหว่าง 40-120 MPa	50
3.9 ค่า Minimum Creep Rate (hr^{-1}) จากการทดสอบการคีบที่ความเค้นการคีบ 80 MPa และที่อุณหภูมิต่างๆ	52
3.10 ค่า Minimum Creep Rate (hr^{-1}) จากการทดสอบการคีบที่ความเค้นการคีบคงที่ 100 MPa และที่อุณหภูมิต่างๆ	53

รายการตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
3.11 ค่า Minimum Creep Rate ($\dot{\epsilon}_{ss}$) ความเสื่อมการคีบคงที่ 120 MPa และที่อุณหภูมิต่างๆ	54
3.12 ค่ายกกำลังของความเสื่อม ทำการทดสอบที่อุณหภูมิ 100, 150, 200 และ 250°C	61
3.13 พลังงานกระตุ้นสำหรับการคีบ ทำการทดสอบที่ความเสื่อมคงที่ 80, 100 และ 120 MPa	62
3.14 ตารางเปรียบเทียบค่า Q_c และค่า n	63
ผง. 1 ข้อมูลการสอบเทียบ LVDT	88

รายการภาพประกอบ

รูปที่	หน้า
1.1 ตัวอย่างแม่พิมพ์งานนิ่ดพลาสติกทำจากโลหะอะลูมิเนียมความแข็งแรงสูง	2
1.2 ผลิตภัณฑ์ของโลหะอะลูมิเนียมผสม	5
1.3 แผนภาพสมดุลไฟฟ้าของอะลูมิเนียม-สังกะสี	12
1.4 ลักษณะของเส้นโค้งการคีบ	16
1.5 เส้นโค้งการคีบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับเวลาที่อุณหภูมิคงที่ และค่าความเค้นต่างๆ ($\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3 > \sigma_4$)	17
1.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า $\log \&$ และค่า $\log \sigma$	18
1.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า $\log \&$ และค่า $\log \sigma$	18
1.8 เส้นโค้งการคีบที่อุณหภูมิต่างๆ ($T_1 > T_2 > T_3 > T_4$) และความเค้นคงที่ σ	19
1.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า $\ln \&$ และค่า $\frac{1}{T}$	20
1.10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $\log(\sigma)$ และ $\log(\&)$ ของโลหะบริสุทธิ์ และโลหะผสมชนิด M (Class M Alloy)	21
1.11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $\log(\sigma)$ และ $\log(\&)$ ของโลหะผสมชนิด A (Class A Alloy)	23
2.1 ชิ้นทดสอบมาตรฐาน ASTM 557M-94	30
2.2 ชิ้นทดสอบการคีบ	30
2.3 อุปกรณ์จับชิ้นทดสอบ (Specimen Holder)	31
2.4 ภาพถ่ายเครื่องทดสอบการคีบพร้อมอุปกรณ์บันทึกข้อมูล	32
2.5 ໂຄອະແກຣມแสดงเครื่องทดสอบการคีบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบันทึกข้อมูล	35
3.1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค็น-ความเครียดวิศวกรรม ของโลหะอะลูมิเนียมผสม เกรด 7075-T651 ทดสอบแรงดึงที่ Strain Rate ($\&$) คงที่ $1 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ และที่อุณหภูมิ ต่างๆ	39
3.2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค็น-ความเครียดวิศวกรรม โลหะอะลูมิเนียมผสม เกรด 7075-T651 ทดสอบที่อุณหภูมิคงที่ 150°C และค่า Strain Rate ($\&$) ต่างๆ ระหว่าง 5.6×10^{-6} และ $1 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$	40

รายการภาพประกอบ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.3 เส้นโค้งการคีบทดสอบที่อุณหภูมิ 100°C ที่ค่าความเค็น 100, 150, 200, 400 และ 410 MPa	42
3.4 เส้นโค้งการคีบทดสอบที่อุณหภูมิ 150°C ที่ค่าความเค็น 80, 100, 150, 200, 300, 320 และ 360 MPa	43
3.5 เส้นโค้งการคีบทดสอบที่อุณหภูมิ 200°C ที่ค่าความเค็น 80, 100, 120 และ 140 MPa	44
3.6 เส้นโค้งการคีบทดสอบที่อุณหภูมิ 250°C ที่ค่าความเค็น 40, 60, 80, 100 และ 120 MPa	45
3.7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า $\log \frac{\sigma}{\sigma_0}$ และค่า $\log \sigma$ ที่อุณหภูมิ 100°C	46
3.8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า $\log \frac{\sigma}{\sigma_0}$ และค่า $\log \sigma$ ที่อุณหภูมิ 150°C	48
3.9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า $\log \frac{\sigma}{\sigma_0}$ และค่า $\log \sigma$ ที่อุณหภูมิ 200°C	49
3.10 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า $\log \frac{\sigma}{\sigma_0}$ และค่า $\log \sigma$ ที่อุณหภูมิ 250°C	50
3.11 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า $\log \frac{\sigma}{\sigma_0}$ และค่า $\log \sigma$ ที่อุณหภูมิ 100, 150, 200 และ 250°C	51
3.12 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า $\ln \frac{\sigma}{\sigma_0}$ และค่า $\frac{1}{T}$ ทดสอบที่ความเค็น 80 MPa	52
3.13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า $\ln \frac{\sigma}{\sigma_0}$ และค่า $\frac{1}{T}$ ทดสอบที่ความเค็น 100 MPa	53
3.14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า $\ln \frac{\sigma}{\sigma_0}$ และค่า $\frac{1}{T}$ ทดสอบที่ความเค็น 120 MPa	54
3.15 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า $\ln \frac{\sigma}{\sigma_0}$ และค่า $\frac{1}{T}$ ทดสอบที่ความเค็นการคีบ 80, 100 และ 120 MPa	55
3.16 โครงสร้างจุลภาคของแผ่นโลหะอะลูминเนียมผสมเกรด 7075-T651 ตามสภาพที่รับมา (As-Received Plate) (a) ภาพด้านหน้า (b) ภาพด้านข้าง และ (c) ภาพด้านบน กัดด้วยสารละลายน้ำ 2.5 mL HNO_3 , 1.5 mL HCl , 1.5 mL HF , 95 mL Water	56

รายการภาพประกอบ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.17 โครงสร้างจุลภาคของโลหะอลูมิเนียมพสมเกรด 7075-T651 ที่ผ่านการให้ความร้อน (Pre-Heated) 30 นาที ที่อุณหภูมิ (a) 100, (b) 150, (c) 200 และ (d) 250°C กัดด้วยสารละลาย 2.5 mL HNO ₃ , 1.5 mL HCl, 1.5 mL HF, 95 mL Water	57
3.18 เปรียบเทียบโครงสร้างจุลภาคของโลหะอลูมิเนียมพสมเกรด 7075-T651 (a) แผ่นตัวอย่างก่อนการทดสอบ (As-Received) (b) ตัวอย่างภายหลัง การทดสอบการคีบที่อุณหภูมิ 150°C ความเค้นการคีบ 100 MPa กัดด้วยสารละลาย 2.5 mL HNO ₃ , 1.5 mL HCl, 1.5 mL HF, 95 mL Water	58
3.19 เปรียบเทียบโครงสร้างจุลภาคของโลหะอลูมิเนียมพสมเกรด 7075-T651 (a) แผ่นตัวอย่างก่อนการทดสอบ (As-Received) (b) ตัวอย่างภายหลัง การทดสอบการคีบที่อุณหภูมิ 200°C ความเค้นการคีบ 100 MPa กัดด้วยสารละลาย 2.5 mL HNO ₃ , 1.5 mL HCl, 1.5 mL HF, 95 mL Water	59
3.20 เปรียบเทียบโครงสร้างจุลภาคของโลหะอลูมิเนียมพสมเกรด 7075-T651 (a) แผ่นตัวอย่างก่อนการทดสอบ (As-Received) (b) ตัวอย่างภายหลัง การทดสอบการคีบที่อุณหภูมิ 250°C ความเค้นการคีบ 100 MPa กัดด้วยสารละลาย 2.5 mL HNO ₃ , 1.5 mL HCl, 1.5 mL HF, 95 mL Water	60
3.21 ค่ายกกำลังของความเค้น ของโลหะอลูมิเนียมพสมเกรด 7075-T651 ในช่วงอุณหภูมิ 100-250°C	61
3.22 ค่าพลังงานกระตุนสำหรับการคีบ ของโลหะอลูมิเนียมพสมเกรด 7075-T651 ในช่วงความเค้นการคีบ 80-120 MPa	63
พค. 1 OMEGA Miniature Displacement Transducers ± 5.0 mm. รุ่น LD400 – 5	78
พค. 2 National Instruments P/N 778629-01 PCI-6031 Low-Cost Multifunction I/O Board for PCI 200 ks/s, 16 - Bit, 16SE/8DI Inputs, 8 DIO, 2 Counter/Time. Kit Includes Hardware and NI-DAQ Driver Software	
พค. 3 National Instruments P/N 776844-01 SCB-68 Shielded Connector Block. I/O Signal Termination Accessory for 68 - Pin MIO Boards. Order SH6868 or R6868 Cable Separately.	79

รายการภาพประกอบ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
พค. 4 National Instruments P/N 184749-01 SH68-68-EP 68-pin to 68-Pin Enhanced Performance Shielded Cable, 1 Meter	79
พค. 5 แหล่งจ่ายไฟปรับค่าได้ 3 เอ็วทพต (Triple Output DC Power Supply) รุ่น EPS 3250A	80
พค. 6 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกข้อมูล	80
พค. 7 Digital Multimeter “FLUKE” รุ่น 179 ช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -40°C ถึง 400°C	81
พค. 8 โพรบของเทอร์โมคัมเปิลประเภท K ขนาด 80BK1	81
พค. 9 สายต่อชนิด TL75 Hard Point Test Lead Set CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10A	82
พค. 10 สายต่อชนิด Alligator Clips to Multi-Stacking Banana Plugs	82
พค. 11 เครื่องทดสอบ HOUNSFIELD TEST EQUIPMENT Model H 100ks Serial No. 0068 พร้อมอุปกรณ์เตาเผาและคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกข้อมูล	83
พค. 12 เทอร์โมคัมเปิล TC Shield = 6 M. TYPE CA (K) JB – 69455	84
พง. 1 อุปกรณ์จับยึด Linear Variable Differential Transformer (LVDT)	86
พง. 2 แสดงการประกอบอุปกรณ์สอบเทียบ LVDT	87
พง. 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Millimeter กับ Volt DC	89
พจ. 1 Desktop คอมพิวเตอร์	91
พจ. 2 Batch Headers	92
พจ. 3 Equipment Setup	92
พจ. 4 Equipment Setup	93
พจ. 5 Calculations	93
พจ. 6 Calculations	94
พจ. 7 Test setting	95
พจ. 8 Desktop คอมพิวเตอร์	95
พจ. 9 Desktop ของ VirtualBench-Logger	97
พจ. 10 หน้าต่างของ Logger Setting	98
พจ. 11 หน้าต่างของ File Configuration	99
พจ. 12 หน้าต่างของ Time Configuration	100
พจ. 13 หน้าต่างของ Transducer Ch0	101

รายการภาพประกอบ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
พจ. 14 หน้าต่างของ Transducer Ch1	102
พจ. 15 หน้าต่างของ VirtualBench-Logger	103